

可在晶圆背面沉积一层可调节、高应力、高质量的薄膜，一步到位地拉平翘曲的晶圆，改善光刻结果，减少由翘曲引起的诸多问题。VECTOR DT 问世之初便得以广泛采用，随着主流 3D NAND 产品向 96 层以上推进，其机台安装数量将会持续增长。

除了沉积高应力薄膜，泛林集团还提供了背面刻蚀的技术，客户可根据工艺需要，在 3D NAND 制造流程中灵活地调整晶圆应力。泛林集团的湿法刻蚀产品 EOS GS 拥有业界领先的湿法刻蚀均匀度，能在充分保护晶圆正面的前提下，同时去除背面和边缘的薄膜，与 VECTOR DT 形

成有力互补。作为晶圆翘曲管理解决方案的一部分，泛林集团的 EOS GS 也被全球存储芯片制造商广泛采用。

泛林集团副总裁兼沉积产品事业部总经理 Sesha Varadarajan 表示：“随着客户产品的存储单元层数持续、大幅的增加，累积应力和晶圆翘曲会超过光刻设备处理能力的极限。为了达到预期良率，实现单位字节成本降低的路线图，将应力引起的畸变降至最低至关重要。伴随 VECTOR DT 和 EOS GS 产品的推出，我们扩大了现有的应力管理解决方案组合，能够全面管理晶圆生产中的应力，支持客户纵向技术的持续发展。”

KLA发布全新缺陷检测与检视产品组合

KLA 公司近日发布 392x 和 295x 光学缺陷检测系统和 eDR7380™ 电子束缺陷检视系统。这些全新的检测系统是 KLA 公司旗舰产品系列——图案晶圆平台的进一步拓展，其检测速度和灵敏度均有提升，代表了光学检测的新水准。全新电子束检视系统的创新使其自身价值进一步稳固，并成为缺陷和发现其产生根源之间的必要一环。对于领先的 3D NAND、DRAM 和逻辑 IC，该产品组合将缩短整个产品周期，加快其上市时间。

离子照射技术，传感器架构和整合芯片设计数据等方面都取得实质性的进步，其灵敏度、产量和良率相关的缺陷分类等功能都是业界翘楚。因此，与领先业界的前一代产品相比，新系统可以更为迅速地发现缺陷并提升良率，同时提供更为全面的在线监控。对于包括 EUV 光刻质量控制在内的各种检测应用，392x 和 295x 系统可以提供不同的波长范围并涵盖从浅沟槽隔离到金属化的所有制程层。

凭借一流的图像质量和通过一次测试获得完整缺陷分



“为了有利润地制造下一代内存和逻辑芯片，对所需的制程控制要求之高也是前所未有的，” KLA 国际产品部执行副总裁 Ahmad Khan 说。“元件结构变得更小、更窄、更高、更深，并且形状更为复杂以及材料更为新颖。将缺陷与其他无害的物理变化分开——也就是从噪声中分离出所需信号——已成为一个非常棘手的难题。我很高兴地宣布我们的光学和电子束工程团队开发了一系列创新的系统，将缺陷的检测和检视相结合，这将推动我们的行业继续向前发展。”

392x 和 295x 光学图案晶圆缺陷检测系统在宽光谱等

布图的独特能力，eDR7380 电子束晶圆缺陷检视系统可以在产品开发中更加迅速地捕获缺陷源，同时在生产制造中更快地检测偏移并且获取更为准确及可操作的数据。该系统能够对脆弱的 EUV 光刻工艺层进行检视。与 KLA 检测仪的独特结合可以缩短获取结果的时间，促进多种的 KLA 特定应用的使用，并通过智能采样和高效缺陷数据交换提升检测的灵敏度。

392x、295x 和 eDR7380 系统都可用作新系统或者对上一代的 39xx、29xx 或 eDR7xxx 系统进行升级。这些系统均具有未来的可扩展性，从而保护晶圆厂的资本投资。